

RCホールディングス

半導体製造装置部品事業を拡大

グループシンナジーを発揮

理研アル
する。

程度。

半導体製造装置マ
ケットは昨年半ばから

RC H Dは理研アル
など中小製
造業4社を
傘下に置く
RCホール
ディングス

RC H Dは理研アル
マイト工業を母体に22
年1月に設立した製造
持株会社。表面処理の
理研アルマイト工業
(川崎市)、保護被膜
ピールシールの関東化
学工業(東京都千代田
区)、歯車の都精機
(東京都三鷹市)、金
属加工のサンエー(山
形市)の4社を傘下に
置き、航空・宇宙など
の分野で金属事業と化
学品事業を展開してい
る。現在の販売構成は、
金属と航空機または滑
走路用融雪剤、洗剤な
どの化学品事業が半々

調整ムードが出ている
が、ここにかけて日本で
の半導体工場新設計画
が浮上。さらに中長期
目線では5GやAI、
I o T、自動車の電装
化といったテーマで成
長が確実視されてい
る。

(RC H D、社長・上
野翼氏)は半導体製造
装置部品ビジネスの拡
大を目指している。2
月に子会社化したサン
エーの金属加工機能と
グループの表面処理や
保護被膜機能を組み合
わせ、付加価値の高い
部品を製造。さらにア
ッセンブリ機能も拡充
し、半導体製造装置部
品業界のニーズを捕捉

RC H Dの金属事業
では、理研アルマイト
工業で半導体製造装置
部品の仕事を手掛ける
ケースはあったが、数
量ベースでは大きいも
ではなかった。しか
し今年2月、ステンレ
スやアルミの切断・機
械加工を手掛けるサン
エーをグループ化した
ことで「ビジネスを深
掘りする準備が整っ
た」(上野社長) 格好

RC H Dは金属素材
の切断・機械加工をサ
ンエーで手掛け、表面
処理を理研アルマイト
工業で対応することが

可能。さらにセミアッ
センブリ機能も保有し
ている強みを生かす方
針で「将来的にはアッ
センブリ機能を充実化
したい」(上野社長)
とする。成長市場と位
置付ける半導体製造装
置ビジネスでの事業拡
大で、ポートフォリオ
の平準化も進める考
え。

